



2017年6月15日

プレスリリース

シリコン・ラボ、Wireless Gecko SoC ポートフォリオの新製品「EFR32xG13」シリーズを発表 Bluetooth® 5 接続に完全対応し、メモリ・オプションを拡張

シリコン・ラボ (本社: 米テキサス州オースチン、Nasdaq: SLAB、以下: シリコン・ラボ) は、Wireless Gecko SoC ポートフォリオを拡張し Bluetooth® 5 仕様に完全対応し、メモリ・オプションを拡張した新マルチバンド対応 SoC の新製品「EFR32xG13」シリーズを発表しました。新 EFR32xG13 SoC シリーズは、開発者が単一の無線通信規格を用いる場合やマルチプロトコルのソリューション、アプリケーションの大容量化、無線によるソフトウェアアップデート(OTA)等に向けてメモリ拡張が必要となるアプリケーションに対応できるよう、さらに高い柔軟性と機能拡張を提供します。また、EFR32xG13 には BOM コストの削減のため高性能オンチップ・オシレータも搭載され、セキュリティの強化、タッチセンサー(静電容量型)、低消費電力センシング、RF 性能の強化がなされています。

EFR32xG13 シリーズは 7 mm x 7 mm QFN48 パッケージでのご提供で、ピン配置はすべての Wireless Gecko SoC シリーズと互換となっており、既存のお客様にとってもメモリ、周辺装置、機能を柔軟にオプション拡張できる製品です。Wireless Gecko 製品ラインアップには、開発者の方々に無償提供されているシリコン・ラボの Simplicity Studio™ 統合開発環境ツール全シリーズをご使用いただけます。

EFR32xG13 Wireless Gecko SoC はサンプル・量産共に対応可能です。Wireless Gecko、Mighty Gecko、Blue Gecko 及び Flex Gecko の各製品の価格・納期及びサンプル並びに、Bluetooth® 5 をサポートする SLWSTK6020B Blue Gecko 開発キット、ならびに Mighty Gecko、Blue Gecko 及び Flex Gecko 向け無線ボード(USD MSRP.) 価格・納期に関しては、シリコン・ラボ国内販売代理店までお問合せください。今回発表した製品の詳細情報は、www.silabs.com/wirelessgecko をご参照ください。

EFR32xG13 シリーズは、Bluetooth® 4 と比較して無線通信距離が 4 倍、通信速度が 2 倍、送信容量が 8 倍と拡大され、他の無線通信プロトコルとの共存性(Co-Existence)も改善された、Bluetooth® 5 の全機能に対応しています。EFR32xG13 SoC シリーズには、送信(TX)・受信(RX)回数の削減により、スループットの高速化や低消費電力化に対応した、2Mbps PHY 仕様が採用されています。また、Bluetooth® 4 を用いた既存デバイスより大幅に長い、4 倍の通信距離を実現する 125Kbps および 500Kbps コードの新 PHY 仕様も内蔵しています。

EFR32xG13 SoC シリーズは、十分なフラッシュメモリ(512KB)と RAM(64KB)を搭載し、ZigBee®、Thread、Bluetooth® 5 によるシングル・プロトコルモードでのアプリケーション実行や、Bluetooth® と ZigBee® や Thread または独自プロトコル・スタック(サブ GHz または 2.4GHz ネットワーク上)を組み合わせた、マルチプロトコルへの対応も可能にしました。EFR32BG13 シリーズの SoC は、Bluetooth® Mesh および Bluetooth® 5 双方のプロトコル・スタックが実行可能で、スマートフォンおよび Bluetooth® による Mesh ネットワーク双方に対応した設計のため、Mesh 系

アプリケーションには理想的な選択肢です。

これらの新 SoC には、BLE (Bluetooth® Low Energy) デバイスに通常必要な、外付け 32KHz 水晶発振機が不要となる、オンチップ・オシレータが内蔵されています。この内蔵型高精度低周波数抵抗コンデンサ回路(RC)オシレータ (PLFRCO)は、BLE のスリープクロック精度仕様対応用に、32KHz 水晶発振機を必要とする量産設計に使用した場合、開発時の BOM コストを米ドルで 0.15 ドル下げることができます。この PLFRCO は、デバイスの動作温度範囲全域にわたって高確度で信頼性の高い BLE 接続が確保されるという点で、他の Bluetooth®デバイスが提供する同様の内蔵オシレータとは一線を画しています。

EFR32xG13 SoC シリーズは、エネルギー効率においても極めて優れており、Energy Star 適合デバイスのバッテリー寿命の延長や電流浪費(エネルギーバンパイア)の削減を可能にします。また、スリープ電流も EFR32xG12 SoC シリーズより 6 パーセント、第 1 世代の Wireless Gecko デバイスより 44 パーセント低くなっています。

EFR32xG13 シリーズは QFN48 パッケージで供給され、ピン配置はすべての Wireless Gecko SoC シリーズと互換性を保持し、既存のお客様にとってもメモリ、周辺装置、機能を柔軟にオプション拡張できる製品です。Wireless Gecko 製品ラインアップには、開発者に無償提供されているシリコン・ラボの [Simplicity Studio™ 統合開発環境ツール](#) 全シリーズをご使用いただけます。

シリコン・ラボラトリーズについて

シリコン・ラボラトリーズ(略称: シリコン・ラボ、NASDAQ: SLAB、本社: 米テキサス州オースチン、www.silabs.com) は、IoT(モノのインターネット)、インターネット基盤、産業オートメーション、民生及び自動車市場向けにシリコン、ソフトウェア、及びシステム・ソリューションを提供する業界大手メーカーです。シリコン・ラボは、エレクトロニクス産業の困難な課題を解決し、性能、省エネルギー、コネクティビティ、設計の簡素化の面で大きなメリットをお客さまにご提供します。ソフトウェア及びミックスドシングナル設計の分野で、卓越した技術力を有する世界クラスのエンジニアリング部門を擁することで、シリコン・ラボは製品開発に携わる皆さまに、初期構想から最終製品に至るまでのプロセス改善に必要なツールをご提供します。会社概要・事業内容の詳細は www.silabs.com をご覧ください。

ご注意

このプレスリリースには、シリコン・ラボラトリーズ社の現時点における期待に基づく予測が含まれていることがあります。このような発言にはリスクと不確実性が伴います。様々な重要な要素が原因となって、予測とは異なる結果になることもあります。シリコン・ラボラトリーズ社では、投資家の方々に社の将来性をお伝えすることが重要と考えますが、正確な予測や管理が不可能な事態が今後発生するかもしれません。シリコン・ラボラトリーズ社の財務成績に影響を与え、実績が将来的記述と著しく異なる場合の要因の詳細については、シリコン・ラボラトリーズ社が米国証券取引委員会(SEC)へ最近提出した書類をご覧ください。

Silicon Laboratories, Silicon Labs, S ロゴ, Silicon Laboratories ロゴ, Silicon Labs ロゴは、Silicon Laboratories Inc.の商標です。その他の登録商標・商標は、それぞれの所有者にその権利が帰属します。

報道関係者お問合せ先

シリコン・ラボラトリーズ Dale Weisman (グローバル広報マネージャ)

TEL: (米国)1-512-532-5871、E メール: dale.weisman@silabs.com

公式ニュースルーム <http://news.silabs.com>,

公式ブログ <http://blog.silabs.com>,

公式 Twitter アカウント <http://twitter.com/silabs>,

公式 Facebook アカウント <http://facebook.com/siliconlabs>,

公式 LinkedIn アカウント www.linkedin.com/company/silicon-labs,

ミアキス・アソシエイツ 河西 E メール: kasai@miacis.com

記事ご掲載時のお問合せ先

シリコン・ラボラトリーズ Y.K.

TEL: 03-5460-2411(代表)

<http://jp.silabs.com>

株式会社マクニカ テクスターカンパニー

〒222-8561 横浜市港北区新横浜 1-6-3 マクニカ第 1 ビル

Tel: 045-470-9841 FAX: 045-470-9844

お問合せ: <https://www.macnica.co.jp/qsmail/tsc/>

<http://www.tecstar.macnica.co.jp/>

以上